

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

333483

ML4

Erstellt:

Nies, Andreas

Kunde:

AV RT

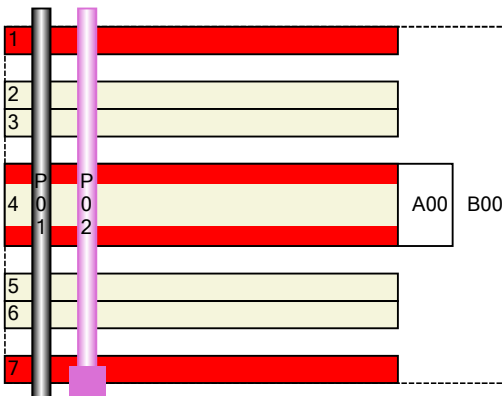
Datum:

29.01.2024



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	215		
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	0		
		18	L2	
B-RAS-ML-0.61-018+018-460x305-TG150HF-...	50202610	610		
		18	L3	
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	215		
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	0		
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	



Dicke nach Verpressen

B00:

1090 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1210 µm

Dmin:

970 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1200 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1320 µm

Dmin:

1080 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1112 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik